

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.5	GHz
工作带宽	2.45-2.55	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-2.1GHz	dBc
带外抑制	30@2.9-6.0GHz	dBc

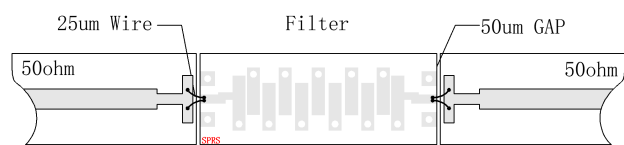
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L : 7.5 , W : 6.5 , h : 0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



PCB Rogers5880, h: 0.254mm	PCB Rogers4350B, h: 0.254mm

注意事项

- 1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
- 3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm；
- 4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线

